### Considerações gerais

- Dispositivo com três terminais.
- Usados em múltiplas aplicações: amplificação de sinais, dispositivos digitais.
- Princípio básico: Uso de uma tensão entre dois terminais para controlar a corrente no terceiro terminal.
- **●** Uso do sinal de controlo de modo a permitir que a corrente no terceiro terminal varie de zero a um valor elevado (dispositivo actuando como interruptor).
- **●** FET Field Effect Transistor

### **Vantagens dos MOSFETs**

■ Comparados com os BJT, os transístores MOS podem ser fabricados muito mais pequenos (i.e., ocupando uma área de silício muito mais pequena na pastilha de circuito integrado), além de o seu processo de fabrico ser mais simples. O consumo de energia é também inferior.



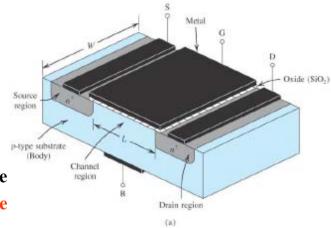


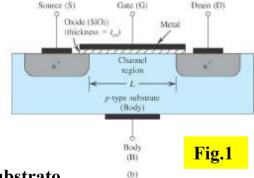
Transistores	Nível de integração	Abreviatura	Exemplo
2 -50	small-scale integration	SSI	
50 - 5000	medium-scale integration	MSI	
5000 - 100,000	Large-scale integration	LSI	Intel 8086 (29,000)
100K - 10 million	very large scale integration	VLSI	Pentium (3 million)
10 million to 1000 million	ultra large scale integration	ULSI	Pentium III (30 million)
1000 million -	super large scale integration	SLSI	

■ Este nível de integração é definido em termos de transístores por circuito.

#### Estrutura do MOSFET

- A Fig. 1 mostra a estrutura física do MOSFET do tipo canal-n enriquecido (à frente veremos o porquê desta designação).
- O transístor é fabricado num substrato do tipo p.
- No substrato, foram criadas duas regiões do tipo n fortemente dopadas, indicadas na Fig. 1 como regiões n+, designadas por fonte (source) e dreno.
- Uma camada fina (tipicamente de 2-50 nm) de dióxido de silício (SiO<sub>2</sub>), (isolante eléctrico), foi desenvolvida na superfície do substrato, cobrindo a área entre as regiões da source e do dreno.
- Seguidamente, deposita-se metal por cima da camada de óxido para formar o eléctrodo "gate" do dispositivo.
- Finalmente, realizam-se contactos metálicos nas regiões da source, dreno e substrato.
- Desta forma, foram criados quatro terminais: os terminais da gate (G), da source (S), do dreno (D) e do substrato ou corpo (B).
- O nome do transístor MOS (metal-óxido-semicondutor) deriva da sua estrutura física.











#### Estrutura do MOSFET

- O substrato forma junções pn com as regiões da source e do dreno. Em funcionamento normal, estas junções pn são mantidas permanentemente inversamente polarizadas.
- Uma vez que o dreno vai estar com uma tensão positiva relativamente à source, as duas junções pn podem ser efectivamente colocadas em corte, ligando simplesmente o terminal do substrato ao terminal da source. Admitese que é esse o caso na descrição do funcionamento do MOSFET a seguir desenvolvida.
- Desta forma, o substrato poderá ser considerado como não tendo nenhum efeito no funcionamento do dispositivo, e o MOSFET poderá ser tratado como um dispositivo de três terminais, i.e., a gate (G), a source (S) e o dreno (D).
- Iremos verificar que uma tensão aplicada à gate controla o fluxo de corrente entre a source e o dreno. Esta corrente flúi na direcção longitudinal do dreno para a source na região designada por "canal".
- A região do canal tem um comprimento L e uma largura W, dois importantes parâmetros do MOSFET. Tipicamente, L tem valores entre 0.11 e 3 μm, e W entre 0.2 e 100 μm.
- O MOSFET é normalmente construído como um dispositivo simétrico. Assim, a source e o dreno podem ser trocados sem alteração das características do transístor.

DEEC

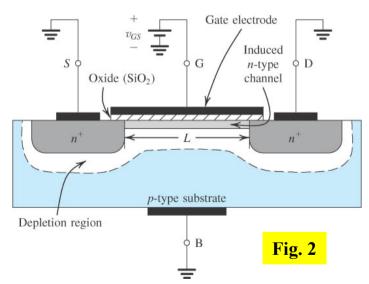
M DEEC

#### Funcionamento sem tensão na gate

- Se não for aplicada qualquer tensão de polarização à gate, entre a source e o dreno existem dois díodos em série opostos.
- Um díodo é constituído pela junção pn formada pela região n+ do dreno e o substrato do tipo p e o outro pela junção formada pelo substrato e a região n+ da source.
- $\blacksquare$  Se se aplicar uma tensão  $v_{DS}$  positiva entre o dreno e a source, a existência destes dois díodos impede que flua corrente entre o dreno e a source.
- $\blacksquare$  De facto, o percurso entre o dreno e a source tem uma resistência muito elevada ( da ordem de  $10^{12} \, \Omega$ ).

#### Criação de um canal para a condução de corrente

- Source e o dreno ligados à massa. Aplicação de uma tensão positiva à gate (Fig. 2).
- ■Uma vez que a source está à massa, toda a tensão da gate aparece entre a gate e a source, pelo que foi designada por  $v_{CS}$ .
- ■A tensão positiva da gate tem dois efeitos:









A tensão positiva da gate tem dois efeitos:

Criação de um canal para a condução de corrente

- Por um lado, origina que as lacunas (cargas positivas) sejam repelidas da região do substrato situada por baixo da gate (a região do canal).
- Estas lacunas são empurradas para baixo, deixando atrás uma região esvaziada de portadores. Esta região de depleção contém iões negativos correspondentes aos átomos aceitadores que perderam as lacunas que foram repelidas.
- Por outro lado, a tensão positiva da gate atrai electrões das regiões n+ da source e do dreno (onde existem em abundância) para a região do canal. Quando o número de electrões acumulado junto da superfície do substrato por baixo da gate é suficiente, constitui-se, de facto, uma região n ligando a source e o dreno, como se indica na Fig. 2.
- Aplicando uma tensão positiva entre o dreno e a source, flúi corrente nesta região n induzida, transportada pelos electrões móveis. A região n induzida forma, assim, um canal por onde a corrente flúi do dreno para a source, pelo que essa designação é apropriada.
- O MOSFET da fig. 2 é chamado MOSFET de canal n ou, alternativamente, transistor NMOS.
- Note-se que um MOSFET de canal n é formado num substrato do tipo p e o canal é criado invertendo a superfície do substrato do tipo p para o tipo n. Por esta razão, o canal induzido é, também, designado por camada de inversão.

Departamento de Engenharia Electrotécnica e de Computadores

6





Criação de um canal para a condução de corrente

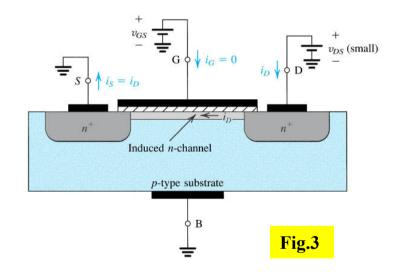
- $\blacksquare$  O valor de  $v_{GS}$  necessário para que um número suficiente de electrões móveis se acumulem na região do canal para formar um canal condutor é chamado tensão limiar e é designado por Vt. Obviamente, Vt para um FET de canal n é positiva. O valor de Vt é controlado durante o fabrico do dispositivo e, tipicamente, toma valores compreendidos entre 0.5 e 1.0 V.
- A gate e o corpo do MOSFET formam um condensador de placas paralelas em que o dieléctrico é a camada de óxido. A tensão positiva da gate faz com que se acumule carga positiva na placa superior do condensador (o eléctrodo da gate). A correspondente carga negativa da placa inferior é formada pelos electrões do canal induzido. Desenvolve-se, assim, um campo eléctrico vertical entre a gate e o substrato. É este campo eléctrico que controla a quantidade de carga no canal, determinando assim a sua condutividade e, consequentemente, a corrente que flúi no canal quando se aplica uma tensão  $v_{\rm DS}$ .

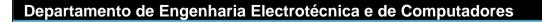
7



### Funcionamento com pequeno valor de v<sub>DS</sub>

- Tendo-se já induzido um canal, aplique-se agora uma tensão v<sub>DS</sub> positiva entre o dreno e a source (Fig. 3).
- $\blacksquare$  Consideremos, primeiramente, o caso em que  $v_{DS}$  é pequena (digamos, 50mV).
- $\blacksquare$  A tensão  $v_{DS}$  faz com que flua uma corrente  $i_D$  no canal n induzido.
- Esta corrente é constituída por electrões que viajam da source para o dreno (daí os nomes source e dreno).
- Por convenção a direcção da corrente é contrária ao fluxo das cargas negativas, logo a corrente no canal é do dreno para a source.
- $\blacksquare$  A grandeza de i<sub>D</sub> depende da densidade de electrões no canal, que, por sua vez, depende da grandeza de v<sub>GS</sub>.







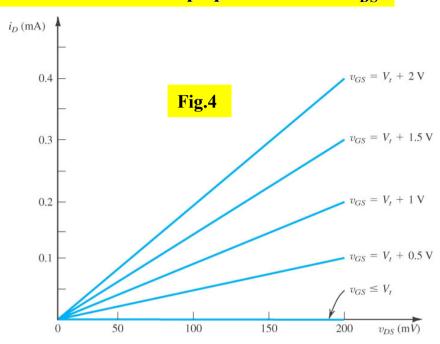
Funcionamento com pequeno valor de V<sub>DS</sub>

- $\blacksquare$  Concretamente, para  $v_{GS} = V_t$  o canal está limiarmente induzido pelo que a corrente é ainda muito pequena.
- Para  $v_{GS}$  > Vt mais electrões são atraídos para o canal (aumento da profundidade) dando origem a uma redução da resistência ou aumento da condutância. A condutância do canal é proporcional à tensão da gate em excesso  $(v_{GS} V_t)$  ou tensão de overdrive  $(V_{OV})$   $(V_{OV} = v_{GS} V_t)$
- $\blacksquare$  A corrente  $i_D$  será proporcional a  $v_{GS}$   $V_t$  e, obviamente, à tensão  $v_{DS}$  que origina  $i_D$ .

M DEEC

- Esboço de  $i_D$  versus  $v_{DS}$  para vários valores de  $v_{GS}$  (Fig. 4).
- **■** Vemos que o MOSFET funciona como uma resistência linear cujo valor é controlado por v<sub>GS</sub>.
- A resistência é infinita para  $v_{GS} \leq V_t$ , . O seu valor diminui à medida que  $v_{GS}$  se torna maior do que  $V_t$ .

#### Funcionamento com pequeno valor de v<sub>DS</sub>



#### **CONCLUSÕES IMPORTANTES**

■ A descrição anterior indica que para o MOSFET conduzir, é necessário induzir um canal. O aumento de  $v_{GS}$  acima da tensão limiar  $V_t$  enriquece o canal, e daí as designações funcionamento em modo de enriquecimento e MOSFET de enriquecimento. Finalmente, notemos que a corrente que sai do terminal da source  $(i_s)$  é igual à corrente que entra pelo terminal do dreno  $(i_p)$  e que a corrente da gate  $i_G = 0$ .

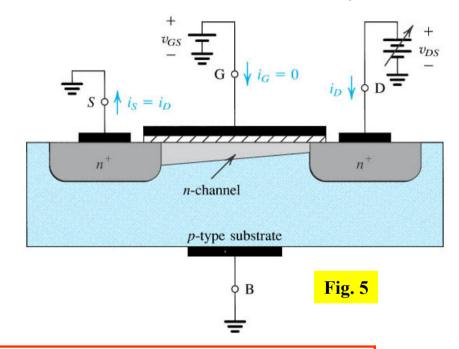






### Funcionamento com v<sub>DS</sub> superiores

- $\blacksquare$  Considere-se, agora, que  $v_{DS}$  se torna maior, e que  $v_{GS}$  é mantida constante num valor maior do que  $V_t$ .
- Note-se que  $v_{DS}$  aparece como uma queda de tensão ao longo do canal, i.e., se percorrermos o canal desde a source até ao dreno, a tensão (medida em relação à source) aumenta de 0 até  $v_{DS}$ .
- Assim, a tensão entre a gate e pontos ao longo do canal diminui desde o valor  $v_{GS}$ , na extremidade da source, até ao valor  $v_{GS}$   $v_{DS}$ , na extremidade do dreno.

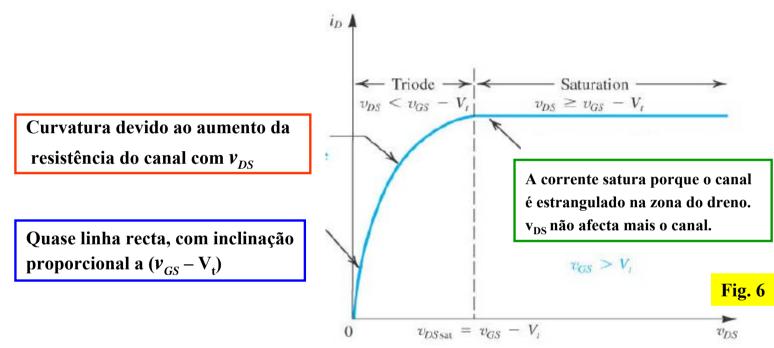


■ Uma vez que a profundidade do canal depende desta tensão, concluímos que o canal não tem, agora, profundidade uniforme; pelo contrário, exibe a forma afunilada que se vê na Fig. 5, com maior profundidade do lado da source e menor do lado do dreno.



### **Funcionamento com v<sub>DS</sub> superiores**

■ Quando  $v_{DS}$  aumenta, o canal torna-se mais afunilado e a sua resistência aumenta correspondentemente. Assim, a curva  $i_D$  -  $v_{DS}$  deixa de ser rectilínea, encurvando como se mostra na fig. 6.



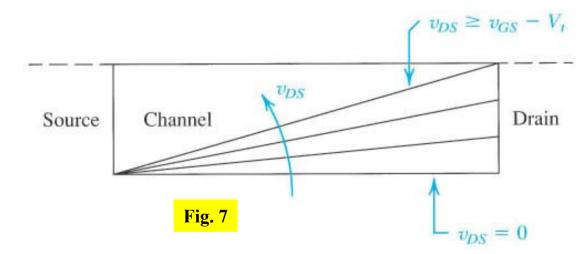
Note-se que à medida que  $v_{DS}$  aumenta, a tensão  $v_{GD} = v_{GS}$  -  $v_{DS}$ , diminui, i.e., a tensão entre a gate e o canal na extremidade do dreno. Quando  $v_{DS}$  atinge o valor que reduz a tensão  $v_{GD}$  ao valor  $V_t$ , i.e.,  $v_{GS}$  -  $v_{DS} = V_t$  ou  $v_{DS} = v_{GS}$  -  $V_t$ , a profundidade do canal do lado do dreno diminui para zero, dizendo-se então que o canal está estrangulado (pinched off).

**Funcionamento com v<sub>DS</sub> superiores** 

#### **Notas Importantes**

- lacktriangle A tensão  $oldsymbol{v_{DS}}$  para a qual ocorre a saturação é designada por  $oldsymbol{v_{DSsat}}$  lacktriangle lacktr
- Para cada valor de  $v_{GS} \ge V_t$ , há um valor correspondente de  $v_{DS,sat}$ .
- O transístor opera na região de saturação se  $v_{DS} \ge v_{DS,sat}$ .
- $\blacksquare$  A região das características i $_D$ - $v_{DS}$  obtidas para  $v_{DS} < v_{DS,sat}$  é chamada região de tríodo, uma designação herdada do tempo das válvulas. Esta região também designada como região óhmica.

Evolução do canal à medida que  $v_{DS}$  aumenta enquanto  $v_{GS}$  permanece constante.





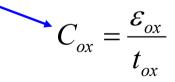


Dedução da relação  $i_D$  –  $v_{DS}$ .

- lacktriangle Assuma-se que a tensão  $v_{GS}$  é aplicada entre a gate e a source com  $v_{GS} > V_t$ ., para induzir o canal.
- Assuma-se, também, que a tensão v<sub>DS</sub> é aplicada entre o dreno e a source.
- $\blacksquare$  Considere-se a operação na região tríodo, para a qual o canal deve ser contínuo e assim  $v_{GS}$  deve ser maior de que  $V_t$ , ou de forma equivalente,  $v_{DS} < v_{GS} V_t$ .
- O canal nestas circunstâncias tem a forma ilustrada na Fig. 8.

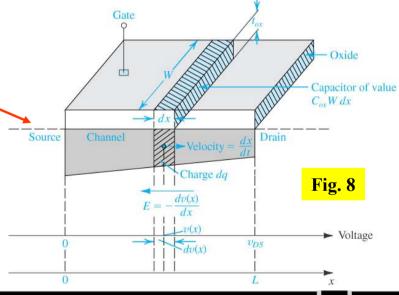
A região do canal forma um condensador plano em que o SiO<sub>2</sub> funciona como dieléctrico.

Capacidade por unidade de área da gate



 $\epsilon_{ox}$  = Permitividade do óxido = 3.9  $\epsilon_{o}$  = 3.45 x 10<sup>-11</sup> F/m

t<sub>ox</sub> é a espessura do óxido





Dedução da relação  $i_D$  –  $v_{DS}$ .

Exemplo

Para 
$$t_{ox} = 10 \text{ nm}$$
  $C_{ox} = 3.45 \times 10^{-3} \text{ F/m}^2$ 

- $\blacksquare$  Considere-se, agora, a faixa infinitesimal da gate a uma distância x da fonte.
- **A** capacidade desta faixa é  $C_{ox}$  W dx.
- Para o cálculo da carga armazenada nesta faixa infinitesimal da gate, multiplica-se a capacidade pela tensão efectiva entre a gate e o canal no ponto x (Q=CV), onde esta tensão é a tensão que é responsável pela indução do canal no ponto x (dada por,  $v_{GS} v(x) V_t$ ) onde v(x) é a tensão no canal no ponto x.
  - A carga do electrão dq na porção infinitesimal do canal, no ponto x, é:

$$dq = -C_{ox}(Wdx)[v_{GS} - v(x) - V_{t}]$$
(1)

O sinal negativo, refere-se ao facto da carga ser negativa.



Dedução da relação  $i_D$  –  $v_{DS}$ 

 $\blacksquare$  A tensão  $v_{DS}$  produz um campo eléctrico ao longo do canal na direcção negativa x. No ponto x, este campo é dado por:

$$E(x) = -\frac{dv(x)}{dx} \tag{2}$$

lacksquare O campo eléctrico E(x) leva a que a carga se movimente em direcção ao dreno, com uma velocidade dx/dt

$$\frac{dx}{dt} = -\mu_n E(x) = \mu_n \frac{dv(x)}{dx}$$
 (3)

Mobilidade dos electrões

- A corrente resultante i pode ser obtida por  $i = \frac{dq}{dt} = \frac{dq}{dx} \frac{dx}{dt}$  (4)
- Usando as equações (1) e (3), vem:

$$i = -\mu_n C_{ox} W[v_{GS} - v(x) - V_t] \frac{dv(x)}{dx}$$
 (5)

Dedução da relação  $i_D - v_{DS}$ 

- Embora calculada num ponto específico do canal, a corrente *i* tem de ser constante em todos os pontos, ao longo do canal.
- **Assim**, a corrente tem de ser igual à corrente da source para o dreno  $(i_D)$

$$i_D = -i = \mu_n C_{ox} W[v_{GS} - v(x) - V_t] \frac{dv(x)}{dx}$$
 (6)

ou

$$i_D dx = \mu_n C_{ox} W[v_{GS} - v(x) - V_t] dv(x)$$

Integrando ambos os lados da equação, com limites de x=0 a x=L, correspondentemente, para v(0)=0 a  $v(L)=v_{DS}$ 

$$\int_{0}^{L} i_{D} dx = \int_{0}^{v_{DS}} \mu_{n} C_{ox} W[v_{GS} - v(x) - V_{t}] dv(x)$$

$$i_{D} = \mu_{n} C_{ox} \frac{W}{L} \left[ (v_{GS} - V_{t}) v_{DS} - \frac{1}{2} v_{DS}^{2} \right]$$
(7)

Expressão que representa a característica i<sub>D</sub>-v<sub>DS</sub> na região do tríodo.

Dedução da relação  $i_D - v_{DS}$ 

O valor da corrente no início da região de saturação, pode ser obtida substituindo  $v_{DS} = v_{GS} - V_t$ 

$$i_D = \frac{1}{2} (\mu_n C_{ox}) \frac{W}{L} (v_{GS} - V_t)^2$$
 (8)

Expressão que representa a característica  $\mathbf{i}_{\mathrm{D}}\text{-}\mathbf{v}_{\mathrm{DS}}$  na região de saturação.

- $\blacksquare$  Para um dado valor de  $v_{GS}$ , obtém-se o correspondente valor de saturação  $i_D$
- $\ ^{\blacksquare}\ \mu_n C_{ox}$  é uma constante determinada pelo processo tecnológico usado para fabricar o MOSFET canal n. É designado por parâmetro de transcondutância do processo.
- Este parâmetro determina o valor da transcondutância do MOSFET, é designado por k'<sub>n</sub> e tem as dimensões de A/V<sup>2</sup>:

Região de tríodo

$$k_n' = \mu_n C_{ox} \qquad (9)$$

■ Substituindo (9) em (8) e (7), resulta:

$$i_{D} = k_{n}^{'} \frac{W}{L} \left[ (v_{GS} - V_{t}) v_{DS} - \frac{1}{2} v_{DS}^{2} \right]$$

Região de saturação

$$i_D = \frac{1}{2} k_n \frac{W}{L} (v_{GS} - V_t)^2$$



Dedução da relação  $i_D - v_{DS}$ 

- Das equações (7) e (8), constata-se que a corrente de dreno é proporcional à relação entre largura do canal W e o comprimento do mesmo L, conhecido "aspect ratio" do MOSFET.
- Os valores de W e de L podem ser seleccionados pelo projectista de modo a obter a característica *i v* desejada.

#### **EXEMPLO 1**

- Considere um processo tecnológico, tal que:  $L_{min} = 0.4 \ \mu m$ ,  $t_{ox} = 8 \ nm$ ,  $\mu_n = 450 \ cm^2/(Vs)$  e  $V_t = 0.7 \ V$ .
- a) Determine  $C_{ox}$  e k'<sub>n</sub>.
- b) Para um mosfet com W/L = 8  $\mu$ m / 0.8  $\mu$ m, calcule os valores de  $V_{GS}$  e de  $V_{DSmin}$ , necessários para operar o transístor na região de saturação com uma corrente de  $I_D$ = 100 $\mu$ A.
- c) Para o dispositivo em (b), determine o valor de  $V_{GS}$  necessário para que o dispositivo opere como uma resistência de 1000  $\Omega$  para um valor muito pequeno de  $v_{DS}$ .



### **SOLUÇÃO**

a) 
$$C_{ox} = \frac{\varepsilon_{ox}}{t_{ox}} = \frac{3.45 \times 10^{-11}}{8 \times 10^{-9}} = 4.32 \times 10^{-3} \text{ F/m}^2$$
  
 $= 4.32 \text{ fF/}\mu\text{m}^2$   
 $k'_n = \mu_n C_{ox} = 450 \text{ (cm}^2/\text{V·s}) \times 4.32 \text{ (fF/}\mu\text{m}^2)$   
 $= 450 \times 10^8 (\mu\text{m}^2/\text{V·s}) \times 4.32 \times 10^{-15} (\text{F/}\mu\text{m}^2)$   
 $= 194 \times 10^{-6} (\text{F/V·s})$   
 $= 194 \mu\text{A/V}^2$ 

(c) Para o mosfet na região do tríodo com  $v_{DS}$  muito pequeno.

$$i_D \equiv k_n' \frac{W}{L} (v_{GS} - V_t) v_{DS}$$

M DEEC

A resistência do dreno para a source  $r_{DS}$ , pode ser determinada:

$$\begin{split} r_{DS} &= \frac{v_{DS}}{i_D} \bigg|_{\text{small } v_{DS}} \\ &= 1 / \left[ k_n' \frac{W}{L} (V_{GS} - V_t) \right] \end{split}$$

(b) Para operação na região de saturação

$$i_D = \frac{1}{2} k_n' \frac{W}{L} (v_{GS} - V_t)^2$$

Assim,

$$100 = \frac{1}{2} \times 194 \times \frac{8}{0.8} (V_{GS} - 0.7)^2$$

Resultando,

$$V_{GS} - 0.7 = 0.32 \text{ V}$$

ou

$$V_{GS} = 1.02 \text{ V}$$

e

$$V_{DSmin} = V_{GS} - V_c = 0.32 \text{ V}$$

$$1000 = \frac{1}{194 \times 10^{-6} \times 10(V_{GS} - 0.7)}$$

$$V_{GS} - 0.7 = 0.52 \text{ V}$$

$$V_{GS} = 1.22 \text{ V}$$

### O MOSFET de canal p

- Um MOSFET de enriquecimento de canal p (transístor PMOS) é fabricado num substrato do tipo n com regiões  $p^+$  para o dreno e a source, e usa lacunas como portadores de carga.
- $\blacksquare$  O dispositivo funciona da mesma maneira que o de canal n, excepto que  $v_{GS}$  e  $v_{DS}$  são negativas e a tensão limiar  $V_t$  é negativa. A corrente  $i_D$  entra pelo terminal da source e sai pelo terminal do dreno.
- De facto, como os portadores de carga nos NMOS são electrões, e estes têm uma mobilidade cerca de três vezes maior do que as lacunas, no silício, os transístores NMOS podem ocupar uma área menor e, assim, serem mais rápidos, além de requererem menores tensões de alimentação.
- Todavia, não se deve ignorar os PMOS por duas razões: os PMOS continuam a ser fabricados para circuitos discretos, e principalmente porque os circuitos CMOS (MOS complementar) que são actualmente a tecnologia dominante, utilizam os dois tipos de transístores, NMOS e PMOS.



#### MOS complementar ou CMOS

- A tecnologia MOS complementar utiliza transístores MOS das duas polaridades.
- De facto, actualmente, a tecnologia CMOS é a mais usada de todas as tecnologias de circuitos integrados MOS, quer no que respeita a circuitos analógicos, quer digitais.

temos uma seccão transversal duma pastilha CMOS os transistores ilustrando como PMOS e NMOS são fabricados.

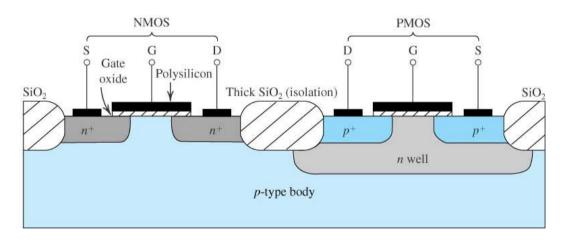


Fig. 9

■ Note-se que enquanto o transístor NMOS é implementado directamente no substrato do tipo p, o transístor PMOS é fabricado numa região n especialmente criada, conhecida como um poço n. Os dois dispositivos são isolados um do outro por uma espessa região de óxido que funciona como um isolante.



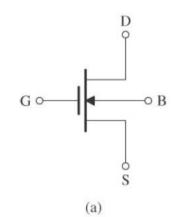


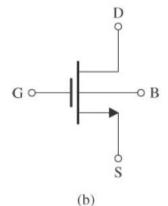
Características tensão-corrente do MOSFET

#### Símbolo de circuito

- A Fig. 10(a) mostra o símbolo de circuito para o MOSFET de enriquecimento de canal n.
- ■O espaço entre as duas linhas verticais, que representam a gate e o canal, indica que o eléctrodo da gate é isolado do corpo do dispositivo.
- A polaridade do substrato do tipo p e o canal n é indicado pela seta do traço que representa o substrato.
- ■Esta seta também indica a polaridade do transístor, i.e., que se trata de um dispositivo de canal n.
- ■Para identificar a source e o dreno (sem ter de escrever S e D), a simbologia do circuito é modificada (ver fig.9b). Para o efeito uma seta é colocada no terminal da source, distinguindo esta do terminal de dreno.

A seta aponta na direcção normal do fluxo de corrente, indicando assim a polaridade dispositivo (i.e. *canal n*)



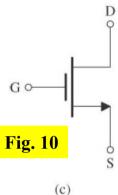


**Fig. 10** 



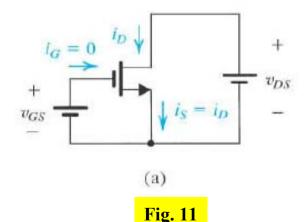
#### Características tensão-corrente do MOSFET

- Embora o símbolo da Fig (b), claramente distinga a source do dreno, na prática é a polaridade da tensão aplicada através do dispositivo que determina a source e o dreno.
- O dreno é sempre positivo relativo à source num FET canal n.
- Em aplicações onde a fonte está ligada ao corpo do dispositivo (situação mais comum), é possível simplificar ainda mais o símbolo do circuito (Fig. 10 (c)).



### Características i<sub>D</sub> - v<sub>DS</sub>

**MOSFET** de canal n enriquecido com tensões  $v_{GS}$  e  $v_{DS}$  aplicadas e indicando os sentidos normais das correntes (Fig.11 (a)).



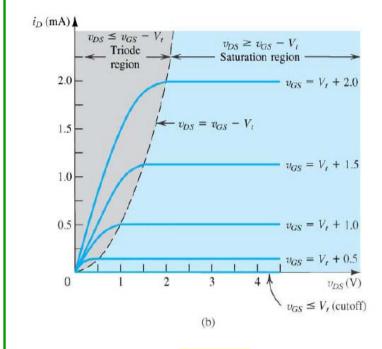
24



Características tensão-corrente do MOSFET

Características i<sub>D</sub> - v<sub>DS</sub>

- Este circuito conceptual pode ser usado para medir as características  $i_D$ - $v_{DS}$ , que são uma família de curvas, cada uma medida com uma tensão  $v_{GS}$  constante.
- É de esperar que cada uma das curvas i<sub>D</sub>-v<sub>DS</sub>, tenha a forma mostrada na Fig. 6.
- ■Na realidade as curvas  $i_D$ - $v_{DS}$  práticas tem o aspecto apresentado na Fig. 11 (b).
- As características da Fig. 11(b) indicam que há três regiões distintas de funcionamento: a região de corte, a região de tríodo e a região de saturação.
- A região de saturação é a região usada para o funcionamento de FET como amplificador.
- Para funcionar como interruptor, utilizam-se as regiões de corte e de tríodo.



**Fig. 11** 

M DEEC

Características tensão-corrente do MOSFET

Características i<sub>D</sub> - v<sub>DS</sub>

- $\blacksquare$  O dispositivo está em corte quando  $v_{GS} < V_t$ .
- Para operar o MOSFET na região de tríodo, precisamos primeiro de induzir o canal,  $\Rightarrow v_{GS} \ge V_t$  (10) e manter  $v_{DS}$  suficientemente pequeno para que o canal permaneça contínuo. Isto consegue-se assegurando que a tensão gate-dreno é:  $v_{GD} > V_t$  (11)
- Esta condição pode ser representada explicitamente em termos de v<sub>DS</sub>.

$$v_{GD} = v_{GS} + v_{SD} = v_{GS} - v_{DS}$$
 Assim,  $v_{GS} - v_{DS} > V_t$  ou  $v_{DS} < v_{GS} - V_t$  (12)

- As Eqs. (11) e (12) constituem as duas condições necessárias para assegurar o funcionamento da região de tríodo.
- Isto é, o MOSFET de canal n enriquecido funciona na região de tríodo quando  $\mathbf{v}_{GS}$  é maior do que  $\mathbf{V}_{t}$  e a tensão de dreno é menor do que a tensão da gate pelo menos de  $\mathbf{V}_{t}$  volt.
- Na região de tríodo, as características i<sub>D</sub>-v<sub>DS</sub> podem ser aproximadamente descritas pela relação.

$$i_{D} = k_{n}^{'} \frac{W}{L} \left[ (v_{GS} - V_{t}) v_{DS} - \frac{1}{2} v_{DS}^{2} \right]$$
 (13)







Características tensão-corrente do MOSFET

Características i<sub>D</sub> - v<sub>DS</sub>

■ Se  $v_{DS}$  for suficientemente pequena, por forma a podermos desprezar o termo  $v_{DS}^2$ , obtemos para as características  $i_D$ - $v_{DS}$  junto da origem, a seguinte relação:

$$i_D \approx k_n^{'} \frac{W}{L} \left[ (v_{GS} - V_t) v_{DS} \right]$$
 (14)

Esta relação linear representa o funcionamento do transístor MOS como uma resistência linear  $r_{DS}$ , cujo valor é controlado por  $v_{GS}$ . Mais especificamente, para um valor em particular  $v_{GS} = V_{GS}$ ,  $r_{DS}$  é dado por:

$$r_{DS} = \frac{v_{DS}}{i_D} \Big|_{v_{GS} = V_{GS}}^{v_{DS} small} = \left[ k_n \frac{W}{L} (v_{GS} - V_t) \right]^{-1}$$
(15)

Operação na região de saturação

Para operar o MOSFET na região de saturação, o canal tem de ser induzido,  $v_{GS} \ge V_t$  (16) e estrangulado na extremidade do dreno, elevando  $v_{DS}$  a um valor que faça com que a tensão gate-dreno se torne inferior a  $V_t$ ,  $v_{GD} \le V_t$  (17)







Características tensão-corrente do MOSFET

Características i<sub>D</sub> - v<sub>DS</sub>

Operação na região de saturação

 $\blacksquare$  A condição pode ser expressa explicitamente em termos de  $v_{DS}$ .

$$v_{DS} \ge v_{GS} - V_t$$
 (Canal estrangulado) (18)

- $\blacksquare$  Isto é, o MOSFET de canal n enriquecido funciona na região de saturação quando  $v_{GS}$  é maior do que  $V_t$  e a tensão de dreno não é inferior à tensão da gate mais do que V, volt.
- A fronteira entre a região de tríodo e a região de saturação é caracterizada por

$$v_{DS} = v_{GS} - V_t \qquad \text{(Fronteira)} \tag{19}$$

 $\blacksquare$  Substituindo este valor de  $v_{DS}$  em

$$i_{D} = k_{n}^{'} \frac{W}{L} \left[ (v_{GS} - V_{t}) v_{DS} - \frac{1}{2} v_{DS}^{2} \right] \qquad \qquad i_{D} = \frac{1}{2} k_{n}^{'} \frac{W}{L} (v_{GS} - V_{t})^{2}$$

$$i_{D} = \frac{1}{2} k_{n}^{'} \frac{W}{L} (v_{GS} - V_{t})^{2}$$
 (20)

Valor de saturação da corrente i<sub>D</sub>





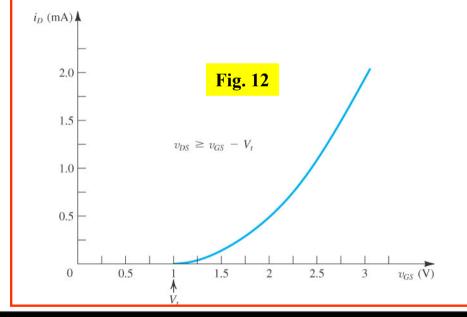
Características tensão-corrente do MOSFET

Características  $i_D$  -  $v_{DS}$ 

**→** 

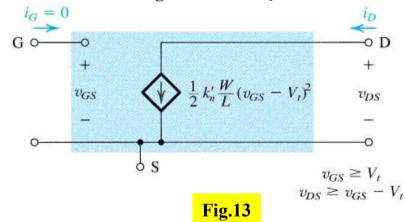
Operação na região de saturação

- Assim, em saturação, o MOSFET fornece uma corrente de dreno cujo valor é independente da tensão de dreno  $v_{DS}$  e é determinado pela tensão da gate  $v_{GS}$  de acordo com a relação quadrática da Eq. (20).
- **■** Um esboço é mostrado na fig. 12.



Como a corrente de dreno é independente da tensão de dreno, o MOSFET saturado comporta-se como uma fonte de corrente ideal cujo valor é controlado por  $v_{\rm GS}$  de acordo com a relação não linear da Eq. (20).

A fig. 13 mostra uma representação do circuito em funcionamento na região de saturação.



Departamento de Engenharia Electrotécnica e de Computadores

29



Características tensão-corrente do MOSFET

Características i<sub>D</sub> - v<sub>DS</sub>

- Voltando às características  $i_D$ - $v_{DS}$  da fig. 11(b), note-se que a fronteira entre as regiões de tríodo e de saturação está representada como uma curva a traço interrompido.
- ■Uma vez que esta curva é caracterizada por  $v_{DS} = v_{GS} V_t$ , a sua equação pode ser obtida substituindo  $v_{GS} V_t$  por  $v_{DS}$ , quer na equação da região de tríodo (Eq. (13)), quer na equação da região de saturação (Eq. (20)).
- Assim,

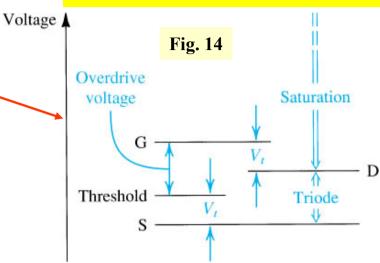
$$i_D = \frac{1}{2} k_n \frac{W}{L} v_{DS}^2$$

- Deve notar-se que as características representadas nas Figs. 4, 11 e 12 são para um MOSFET com  $k_n'(W/L) = 1.0 \text{ mA/V}^2 \text{ e V}_t = 1 \text{ V}.$
- O diagrama da fig. 14 mostra os níveis relativos que as tensões terminais do transístor NMOS de enriquecimento devem ter para o funcionamento nas regiões de tríodo e de saturação.

M DEEC

Características tensão-corrente do MOSFET

Níveis de tensão relativos nos terminais para um NMOS para funcionamento na região de tríodo e saturação



#### Exercício 1

Um transístor NMOS de enriquecimento com  $V_t$ =0,7 V tem a source ligada à massa e uma tensão de 1,5 V aplicada à gate. Quais as regiões de funcionamento para: (a)  $V_D$ =0,5 V; (b)  $V_D$ =0,9 V; (b)  $V_D$ =3 V.

#### Exercício 2

Se o transístor NMOS do Exercício 2 tiver mCox=100mA/V<sup>2</sup>, W=10mm e L=1mm, determine o valor da corrente de dreno para as três situações indicadas (a), (b) e (c).

Departamento de Engenharia Electrotécnica e de Computadores

31





Características tensão-corrente do MOSFET

Resistência de saída finita em saturação

- $\blacksquare$  A equação (14) e o circuito equivalente correspondente da Fig. 13, indicam que na saturação  $i_D$  é independente de  $v_{DS}$ .
- $\blacksquare$  A variação  $\Delta v_{DS}$  na tensão dreno-source causa uma variação nula em  $i_D$ , o que implica que a resistência incremental na direcção do dreno de um MOSFET saturado é infinita.
- Isto é no entanto uma idealização baseada na premissa de que, uma vez o canal estrangulado na extremidade do dreno, posteriores aumentos de v<sub>DS</sub> não têm qualquer efeito sobre a forma do canal.
- $\blacksquare$  Na prática o aumento de  $v_{DS}$  para além de  $v_{DS,sat}$  afecta um pouco o canal.
- $\blacksquare$ Concretamente, à medida que  $v_{DS}$  aumenta, o ponto de estrangulamento do canal move-se ligeiramente do dreno em direcção à source.
- ■Tal é ilustrado na Fig. 15, da qual se nota que a tensão ao longo do canal permanece constante:

$$v_{DSat} = v_{GS} - V_t$$

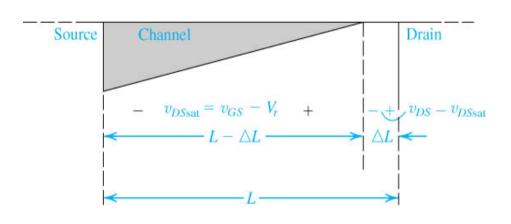
e a tensão adicional aplicada ao dreno, surge como uma queda de tensão através da região de depleção estreita, entre o fim do canal e a região do dreno.



Características tensão-corrente do MOSFET

Resistência de saída finita em saturação

- Esta tensão acelera os electrões que atingem o fim do dreno do canal, varrendo-os para o dreno através da região de depleção.
- Com a largura da camada de depleção, o comprimento do canal é reduzido de L para L-ΔL
- Este fenómeno é designado por modulação do comprimento do canal.
- Visto que  $i_D$  é inversamente proporcional ao comprimento do canal (eq. 20), com a diminuição deste,  $i_D$  aumenta com o aumento de  $v_{DS}$ .



**Fig. 15** 

Características tensão-corrente do MOSFET

#### Resistência de saída finita em saturação

■ Para levar em consideração a dependência de i<sub>p</sub> em função de v<sub>ps</sub>, na saturação, substitui-se L, na eq. 20, por L -  $\Delta$ L, obtendo-se:

$$i_D = \frac{1}{2} k_n' \frac{W}{L - \Delta L} (v_{GS} - V_t)^2 = \frac{1}{2} k_n' \frac{W}{L} \frac{1}{1 - (\Delta L/L)} (v_{GS} - V_t)^2$$

$$\cong \frac{1}{2} k_n \frac{W}{L} \left( 1 + \frac{\Delta L}{L} \right) (v_{GS} - V_t)^2$$
 (assumido que (\Delta L/L) <<1)

- Assumindo que  $\Delta L$  é proporcional a  $v_{DS}$   $\Delta L = \lambda v_{DS}$
- $\blacksquare$   $\lambda$ ' é um parâmetro relacionado com o processo tecnológico, com dimensões de  $\mu$ m/V.
- Substituindo na expressão de i<sub>n</sub>:

Usualmente  $\lambda'/L$  é designado por  $\lambda$ 

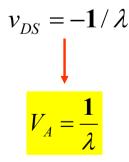
$$i_{D} = \frac{1}{2} k_{n}^{'} \frac{W}{L} \left( 1 + \frac{\lambda^{'}}{L} v_{DS} \right) (v_{GS} - V_{t})^{2} = \frac{1}{2} k_{n}^{'} \frac{W}{L} (v_{GS} - V_{t})^{2} (1 + \lambda v_{DS})$$
 (21)

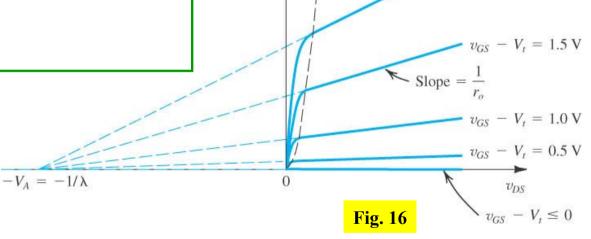


Características tensão-corrente do MOSFET

Resistência de saída finita em saturação

- $\blacksquare$  A fig. 16 mostra um conjunto típico de características i $_{D}$ - $v_{DS}$  exibindo o efeito da modulação do comprimento do canal.
- A dependência linear observado entre i<sub>p</sub> e v<sub>ps</sub>, na região de saturação, é representada na equação (21) pelo factor  $(1 + \lambda v_{ps})$ .
- Na fig. 16 notamos que prolongando para a esquerda a parte rectilínea das características i<sub>D</sub>-v<sub>DS</sub> na saturação, elas intersectamse num mesmo ponto do eixo  $v_{DS}$ , caracterizado por  $v_{DS}$  = -1/ $\lambda$  = - $\mathbf{V}_{\mathbf{A}}$ , onde  $\mathbf{V}_{\mathbf{A}}$  é uma tensão positiva.
- Da equação 21, se  $i_D = 0$ , então:





← Saturation

Triode



Características tensão-corrente do MOSFET

#### Resistência de saída finita em saturação

- V<sub>A</sub> é um parâmetro do processo tecnológico, com dimensões de Volt designada como tensão de Early.
- $\blacksquare$  Para um dado processo,  $V_A$  é proporcional ao comprimento do canal L, que o projectista seleccione para um MOSFET.
- Pode-se representar  $V_A=V_A$ ' L, em que  $V_A$ ' é inteiramente dependente do processo tecnológico, cujas unidades são  $V/\mu m$ .
- ■Tipicamente, V<sub>A</sub>' varia na gama de 5 V/μm a 50 V/μm.
- $\blacksquare$  A equação 21, indica que quando a modulação do comprimento do canal é considerada, os valores de saturação de  $i_D$  dependem de  $v_{DS}$ .
- ${}^{\blacksquare}$ Assim, para um dado  $v_{GS}$ , uma variação  $\Delta v_{DS}$  produz uma correspondente variação  $\Delta i_{D}$ , na corrente de dreno  $i_{D}$ .
- **■**Uma consequência óbvia da modulação do comprimento do canal é que a resistência de saída em saturação é finita.
- Definindo a resistência de saída  $r_o$  (resistência em saturação) como,  $r_o \equiv \left| \frac{\partial r_D}{\partial v_{DS}} \right|$



Características tensão-corrente do MOSFET

Resistência de saída finita em saturação

■ Usando as equações (21) e (22) podemos obter

$$r_{o} = \left[ \lambda \frac{k_{n}^{'}}{2} \frac{W}{L} (v_{GS} - V_{t})^{2} \right]^{-1}$$
 (23)

■ A equação (23) pode ser escrita de modo simplificado como

$$r_o = \frac{1}{\lambda I_D} \qquad (24) \qquad \qquad ou \qquad \qquad r_o = \frac{V_A}{I_D} \qquad (25)$$

■ Em que I<sub>D</sub> é a corrente de dreno sem levar em consideração a modulação do comprimento do canal.

$$I_{D} = \frac{1}{2} k_{n} \frac{W}{L} (v_{GS} - V_{t})^{2}$$

Assim a resistência de saída é inversamente proporcional à corrente de dreno.

 $i_{G} = 0$  +  $v_{GS}$   $\frac{1}{2} k'_{n} \frac{W}{L} (v_{GS} - V_{t})^{2}$   $r_{o}$   $r_{o}$ Fig. 17

**Modelo de circuito equivalente, incorporando**  $r_o$ .

